

第二届集成芯片和芯粒大会
THE 2nd INTEGRATED CHIPS AND CHIPLET CONFERENCE

第二届集成芯片和芯粒大会邀请函

敬启者：

以“集成芯片：迈进大芯片时代”为主题的第二届集成芯片和芯粒大会将于2024年11月8日-10日在北京嘉里大酒店举行。集成芯片（Integrated Chips）是通过微纳工艺将若干芯粒（Chiplet）再次集成的技术，以形成单芯片更高集成度、更丰富功能的芯片和系统。集成芯片的研究聚焦在芯粒规模和种类大幅度提升后带来的全新问题，致力于发展出一条不单纯依赖尺寸微缩的性能提升新路径。

本次大会由中国科学院计算技术研究所、复旦大学主办，由孙凝晖院士和刘明院士担任大会主席。本次大会将探讨集成芯片与芯粒技术的前沿动态与未来发展趋势，包括集成芯片体系结构和电路设计、集成芯片数学基础和EDA、多物理场仿真、集成技术等热点议题。本次大会将通过主题演讲、专家圆桌论坛、黑科技发布会、技术论坛、开源社区大赛等形式对上述问题进行探讨。

我们非常荣幸邀请您参加此次大会，共同探讨集成芯片技术的发展趋势。如有其他需要，请提前与组委会联系。最后向您致以诚挚的问候！

附件：会议详细信息

第二届集成芯片和芯粒大会组委会

复旦大学集成芯片与系统全国重点实验室



2024年10月21日

附件：会议详细信息

1、会议主办单位

中国科学院计算技术研究所

复旦大学

2、会议承办单位

集成电路与系统全国重点实验室

处理器芯片全国重点实验室

集成电路制造技术重点实验室（中国科学院）

绍芯实验室

芯片与系统前沿技术研究院

3、会议信息

会议时间：2024年11月8日-10日（周五、周六、周日）

会议地点：北京嘉里大酒店（朝阳区光华路1号）

报到时间：2024年11月7日14:00-9日14:00

报到地点：北京嘉里大酒店1层

4、注册费标准

学生票价格为1000元（不含晚宴），非学生票价格为2000元。

门票类型	参会者身份	2024.10.18- 2024.11.10
会议注册费	学生	¥1000
	非学生	¥2000

5、注册和支付方式

扫描下方二维码，或登录会议官方网站 (<https://2024.iccconf.cn/>)，点击“注册缴费”→提交信息→“我要缴费”。



大会主页二维码



会议注册二维码

6、联系方式

会议联系人：王梦迪

联系电话：18811367122

联系邮箱：wangmengdi@ict.ac.cn

